Numer referencyjny postępowania:

**WSZ-EP-40/2023**

**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Pakiet 1**

**Procesor dźwięku – 15 zestawów**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** |
| 1. | **Część implantowa** |
| 1 | Kompatybilny z implantami ślimakowymi: CI24M, CI24R, CI24RE, CI422, CI512, CI522, CI532, CI612, CI622, CI632 |
| 2 | W ramach oferowanej ceny możliwość wyboru procesora (wraz z komponentem akustycznym) realizującego łączoną stymulację elektryczno-akustyczną w jednym urządzeniu |
| 3 | W ramach oferowanej ceny możliwość dostarczenia procesora mowy w min. 5 różnych opcjach kolorystycznych |
| 4 | Możliwość zasilania akumulatorowego |
| 5 | W ramach oferowanej ceny dostarczenie dodatkowego przewodu łączącego procesor z transmiterem lub dodatkowego przewodu zintegrowanego z transmiterem |
| 6 | Odporność na wnikanie pyłu i zachlapanie wodą: stopień ochrony IP68 (lub równoważny) |
| 7 | Możliwość bezprzewodowego przesyłania dźwięku pomiędzy procesorem a kompatybilnymi urządzeniami wyposażonymi w system operacyjny iOS lub Android |
| 8 | W ramach oferowanej ceny możliwość wyboru jednomodułowego procesora dźwięku |

**Pakiet 2**

**Procesor dźwięku do systemu implantu zakotwiczonego w kości, 55 dB HL, albo 65 dB HL (w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego) – 10 zestawów**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** |
| 1 | Procesor dźwięku z możliwością kompensacji w zależności od poziomu niedosłuchu pacjenta - 55 dB HL albo 65 dB HL. Pełna dostępność wzmocnienia w zależności od zapotrzebowania |
| 2 | Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne ze wspornikami Cochlear typu BA200, BA210, BA300, BA400 |
| 3 | Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne z magnesem zewnętrznym w przypadku systemu magnetycznego lub rozważanej u pacjenta w przyszłości wymiany wspornika na magnes. |
| 4 | Sposób zatrzaskiwania samego procesora uniwersalne – w zależności od rozwiązania: do wewnątrz wspornika implantu lub do wewnątrz zaczepu magnesu. Bezpośrednie połączenie procesora ze wspornikiem lub magnesem bez konieczności użycia dodatkowych elementów pośredniczących.  |
| 5 | Możliwość uzyskania informacji dźwiękowej i wizualnej o stanie pracy urządzenia (włączanie, wyłączanie, zmiana programów, poziomu głośności) oraz stanie naładowania baterii procesora dźwięku |
|  6 | Dostępność w min. 4 kolorach – oryginalna obudowa procesora |
| 7 | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli. Możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzania statusu pracy za pomocą pilota lub telefonu komórkowego bez dodatkowych urządzeń pośredniczących |
| 8 | Możliwość podłączenia procesora do elastycznej opaski |
| 9 | Możliwość programowania procesora dźwięku w sposób przewodowy i bezprzewodowy (procesor dźwięku łączony przewodem z interfejsem jak również procesor dźwięku komunikujący się bezprzewodowo z interfejsem) |

**Pakiet 3**

**System aktywnego implantu słuchowego ucha środkowego- 2 zestawy**

|  |  |
| --- | --- |
|  Lp. | **PARAMETRY WYMAGANE** |
| 1. | System częściowo wszczepialny- procesor dźwięku zawierający moduł/baterie zasilające umieszczony poza ciałem. |
| 2 | Zakres dopasowania systemu pozwala na kompensację ubytków słuchu typu mieszanego i przewodzeniowego, dla których wartości wzmocnienia progów słyszenia dla przewodnictwa kostnego zawierają się w przedziale co najmniej od 0 dB HL do 55 dB HL. |
| 3 | Zastosowanie w kompensacji niedosłuchów typu przewodzeniowego, mieszanego oraz jednostronnej głuchoty w opcji CROS (contralateral routing of signal). |
| 4 | Wszczepialny aktywny przetwornik drgający (implant) wywołujący wymuszone drgania mechaniczne (wibracje) w obrębie kości czaszki mocowany w kości czaszki w 1 punkcie |
| 5 | Możliwość usytuowania aktywnego przetwornika drgającego (implantu) w różnych pozycjach (miejscach) w kości czaszki w zależności od uwarunkowań anatomicznych pacjenta. |
| 6 | Przetwornik drgający mocowany do implantu wykonanego z tytanu, samogwintującego się o dostępnych długościach 3mm lub 4mm. |
| 7 | Aktywny przetwornik drgający (implant) bez wewnętrznych źródeł zasilania, całkowicie umieszczany podskórnie. |
| 8 | Cyfrowe przetwarzanie sygnału w procesorze zewnętrznym. |
| 9 | Przezskórna transmisja radiowa sygnału z procesora (części zewnętrznej) do aktywnego przetwornika/implantu drgającego. Część wewnętrzna (implant) niepołączona mechanicznie z częścią zewnętrzną (procesorem). |
| 10 | Aktywny przetwornik drgający kompatybilny z niezależnym implantem tytanowym |
| 11 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI do 3.0 Tesla bez konieczności usuwania całego implantu. |
| 12 | System implantu przystosowany do obu uszu. |
| 13 | Procesor dźwięku wyposażony w dwa mikrofony |
| 14 | Dioda sygnalizująca pracę procesora dźwięku |
| 15 | Procesor dźwięku zasilany standardowymi bateriami dostępnymi na rynku |
| 16 | Ochrona przed wnikaniem czynników zewnętrznych spełniająca normę min. IP54 |
| 19 | Możliwość elektronicznej identyfikacji implantu przez procesor dźwięku |
| 20 | Dostarczenie oprogramowania do przeprowadzenia pomiarów śródoperacyjnych (jeśli wymagane) oraz dopasowywania procesora dźwięku. |
| 21 | Wszystkie niezbędne podczas zabiegu chirurgicznego elementy jednorazowego użytku (komplet jednorazowy) dostarczone w ilości sztuk odpowiadającej wolumenowi zamówienia. |
| 22 | Zestaw chirurgiczny do przeprowadzenia implantacji zapewniony na czas zabiegu – odbiór i zwrot potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem |

|  |  |
| --- | --- |
| **L.P.** | **Parametry** |
| **1** | **2** |
| **1.** | Badanie progów słyszenia dla przewodnictwa kostnego poprzez procesor z wykorzystaniem standardowego oprogramowania producenta (tzw. audiometria in-situ). |
| **2.** | Manualna regulacja zmiany programu |
| **3.** | Zmiana programów oraz ustawień procesora dźwięku w zakresie niskich, średnich oraz wysokich częstotliwości możliwa z poziomu aplikacji na telefon. |
| **4.** | Informacja akustyczna dla pacjenta o wyczerpującej się baterii. |
| **5.** | Informacja wizualna (dioda LED na obudowie procesora) o stanie baterii. |
| **6.** | Możliwość bezprzewodowego programowania procesora dźwięku. |

**Uwaga!**

Powyższe parametry stanowią wymagania minimalne. Niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.